



## 2021年3月期 第3四半期決算短信(日本基準)(連結)

2021年1月28日

上場会社名 東京エレクトロン株式会社

上場取引所 東

コード番号 8035 URL <https://www.tel.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 河合 利樹

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 笹川 謙

TEL 03-5561-7000

四半期報告書提出予定日 2021年2月12日

配当支払開始予定日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

### 1. 2021年3月期第3四半期の連結業績(2020年4月1日～2020年12月31日)

#### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2021年3月期第3四半期	959,885	19.4	210,297	25.8	210,652	22.7	158,179	23.5
2020年3月期第3四半期	803,896	16.2	167,164	28.6	171,645	29.0	128,052	30.5

(注) 包括利益 2021年3月期第3四半期 188,002百万円 (36.6%) 2020年3月期第3四半期 137,600百万円 (22.1%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2021年3月期第3四半期	1,017.21	1,011.30
2020年3月期第3四半期	804.74	800.25

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2021年3月期第3四半期	1,270,407	906,723	70.4
2020年3月期	1,278,495	829,692	64.1

(参考) 自己資本 2021年3月期第3四半期 894,790百万円 2020年3月期 819,301百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2020年3月期		246.00		342.00	588.00
2021年3月期		360.00			
2021年3月期(予想)				380.00	740.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

### 3. 2021年3月期の連結業績予想(2020年4月1日～2021年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	1,360,000	20.6	306,000	29.0	306,000	24.9	230,000	24.2	1,479.06

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

## 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

詳細は、「添付資料」10ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

以外の会計方針の変更 : 無

会計上の見積りの変更 : 無

修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)

2021年3月期3Q	157,210,911 株	2020年3月期	157,210,911 株
------------	---------------	----------	---------------

期末自己株式数

2021年3月期3Q	1,705,858 株	2020年3月期	1,685,556 株
------------	-------------	----------	-------------

期中平均株式数(四半期累計)

2021年3月期3Q	155,504,372 株	2020年3月期3Q	159,122,554 株
------------	---------------	------------	---------------

(注) 期末自己株式数には、「役員報酬BIP信託」及び「株式付与ESOP信託」が保有する当社株式(2021年3月期3Q 617,378株、2020年3月期472,030株)を含めております。また、各信託が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

## 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、「添付資料」5ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

・当社は、2021年1月28日に機関投資家・アナリスト向けにウェブ説明会を開催する予定です。この説明会で使用する決算説明資料につきましては、当社ホームページに掲載する予定です。

## 【添付資料】

## [目次]

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	5
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	6
(1) 四半期連結貸借対照表	6
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	8
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10
(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)	10
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	10
(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)	10
(セグメント情報等)	11

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

## (1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間の世界経済につきましては、前第2四半期に引き続き、新型コロナウイルスの感染蔓延による影響が見られるものの、当社グループの参画しておりますエレクトロニクス産業におきましては、IoT、AI、5G等の情報通信技術の用途の拡がりに伴う旺盛な半導体需要により、半導体製造装置市場の拡大基調は継続しております。

このような状況のもと、当社グループの当第3四半期連結累計期間の連結業績は、売上高9,598億8千5百万円(前年同期比19.4%増)、営業利益2,102億9千7百万円(前年同期比25.8%増)、経常利益2,106億5千2百万円(前年同期比22.7%増)、また、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,581億7千9百万円(前年同期比23.5%増)となりました。

セグメント別の概況は以下のとおりです。

## ① 半導体製造装置

拡大する半導体需要を背景に、顧客の設備投資は堅調に推移しました。メモリにおいては在庫調整がすすみ、需給バランスの改善が見られ、またロジック/ファウンドリ向け半導体に対する設備投資も高水準で推移しました。このような状況のもと、当セグメントの当第3四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、8,997億6千2百万円(前年同期比19.6%増)となりました。

## ② FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置

テレビ用大型液晶パネル向けの設備投資は継続し、モバイル用中小型有機ELパネル向けの設備投資も堅調に推移しました。市場が最も大きい中国における新型コロナウイルスの影響による装置立ち上げの遅延は解消され、前第2四半期から売上高は増加しました。このような状況のもと、当セグメントの当第3四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、600億2千5百万円(前年同期比16.1%増)となりました。

## ③ その他

当セグメントの当第3四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、9千8百万円(前年同期比36.1%減)となりました。

(ご参考)

【連結業績】

(単位：百万円)

	当期			
	第1Q	第2Q	第3Q	第3Q累計
売上高	314,823	353,337	291,725	959,885
半導体製造装置	303,772	331,684	264,305	899,762
日本	49,150	56,852	36,149	142,152
北米	42,343	44,009	34,501	120,854
欧州	15,774	16,311	12,797	44,883
韓国	67,013	72,199	39,318	178,531
台湾	50,926	53,914	52,513	157,354
中国	73,957	79,123	70,541	223,622
東南アジア他	4,605	9,274	18,483	32,364
F P D製造装置	11,013	21,623	27,388	60,025
その他	37	29	31	98
営業利益	73,849	73,579	62,868	210,297
経常利益	75,089	73,138	62,424	210,652
親会社株主に帰属する 四半期純利益	56,452	55,559	46,167	158,179

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

## (2) 財政状態に関する説明

## ① 財政状態

当第3四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ548億4千4百万円減少し、9,076億3千9百万円となりました。主な内容は、有価証券に含まれる短期投資の減少685億円、受取手形及び売掛金の減少119億8千2百万円、未収消費税の減少105億1千9百万円、たな卸資産の増加351億6千7百万円によるものであります。

有形固定資産は、前連結会計年度末から130億4千9百万円増加し、1,886億2千9百万円となりました。

無形固定資産は、前連結会計年度末から42億6千万円増加し、151億8千2百万円となりました。

投資その他の資産は、前連結会計年度末から294億4千6百万円増加し、1,589億5千5百万円となりました。

これらの結果、総資産は、前連結会計年度末から80億8千7百万円減少し、1兆2,704億7百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ867億1百万円減少し、2,958億7千6百万円となりました。主として、前受金の減少518億2千1百万円、未払法人税等の減少171億3千2百万円、賞与引当金の減少107億8千4百万円によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ15億8千2百万円増加し、678億7百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ770億3千1百万円増加し、9,067億2千3百万円となりました。主として、親会社株主に帰属する四半期純利益1,581億7千9百万円を計上したことによる増加、前期の期末配当及び当期の中間配当1,095億4千2百万円の実施による減少、その他有価証券評価差額金の増加257億5千7百万円によるものであります。この結果、自己資本比率は70.4%となりました。

## ② キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の当第3四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ194億6千9百万円減少し、2,284億9千万円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資405億7千3百万円を加えた残高は、前連結会計年度末に比べ693億4千3百万円減少し、2,690億6千3百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、前年同期に比べ1,060億7千5百万円減少の872億7千2百万円の収入となりました。主な要因につきましては、税金等調整前四半期純利益2,100億4千4百万円、減価償却費241億1千6百万円、売上債権の減少128億2千1百万円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、法人税等の支払額698億6千5百万円、前受金の減少525億5千4百万円、たな卸資産の増加334億6千5百万円がそれぞれキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主として定期預金及び短期投資の減少による収入498億8千万円、有形固定資産の取得による支出376億5千2百万円により、前年同期の378億6千8百万円の収入に対し58億3千4百万円の収入となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に配当金の支払1,095億4千2百万円、自己株式の取得による支出43億3千5百万円により、前年同期の2,499億2千2百万円の支出に対し1,143億9千2百万円の支出となりました。

## 【連結キャッシュ・フロー(要約)】

(単位：百万円)

	前第3四半期 連結累計期間	当第3四半期 連結累計期間
営業活動によるキャッシュ・フロー	193,348	87,272
税金等調整前四半期純利益	171,255	210,044
減価償却費	20,498	24,116
売上債権の増減額(△は増加)	20,265	12,821
たな卸資産の増減額(△は増加)	△35,363	△33,465
仕入債務の増減額(△は減少)	12,816	△61
その他	3,876	△126,182
投資活動によるキャッシュ・フロー	37,868	5,834
定期預金及び短期投資の増減額(△は増加)	80,000	49,880
その他(固定資産の取得等)	△42,131	△44,045
財務活動によるキャッシュ・フロー	△249,922	△114,392
自己株式の取得	△154,092	△4,335
その他(配当金の支払等)	△95,829	△110,056
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,652	1,815
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△20,357	△19,469
現金及び現金同等物の期首残高	232,634	247,959
現金及び現金同等物の四半期末残高	212,277	228,490
現金及び現金同等物並びに満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資の四半期末残高	292,277	269,063

## (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

IoT、AI、5G等の情報通信技術の用途の拡がりに伴う旺盛な半導体需要を背景に半導体製造装置市場の拡大基調は継続しており、通期連結業績予想につきまして、最新の顧客の設備投資動向と業績動向に鑑み、2020年10月29日に公表した数値を以下のとおり修正いたします。

## 2021年3月期通期の連結業績予想

	今回修正予想	前回予想 (2020年10月29日公表)
売上高	1兆3,600億円 (前期比 20.6%増)	1兆3,000億円
半導体製造装置	1兆2,800億円 (前期比 20.6%増)	1兆2,200億円
FPD製造装置	800億円 (前期比 21.0%増)	800億円
営業利益	3,060億円 (前期比 29.0%増)	2,810億円
経常利益	3,060億円 (前期比 24.9%増)	2,810億円
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,300億円 (前期比 24.2%増)	2,100億円

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

※この決算短信に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否、並びに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

## 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	149,906	149,063
受取手形及び売掛金	150,134	138,152
有価証券	188,500	120,000
商品及び製品	267,625	284,794
仕掛品	69,514	76,794
原材料及び貯蔵品	54,924	65,644
その他	81,983	73,277
貸倒引当金	△105	△85
流動資産合計	962,484	907,639
固定資産		
有形固定資産	175,580	188,629
無形固定資産		
その他	10,921	15,182
無形固定資産合計	10,921	15,182
投資その他の資産		
その他	130,922	160,338
貸倒引当金	△1,413	△1,382
投資その他の資産合計	129,509	158,955
固定資産合計	316,011	362,768
資産合計	1,278,495	1,270,407



(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	95,938	96,944
未払法人税等	52,654	35,522
前受金	135,326	83,504
賞与引当金	29,139	18,354
製品保証引当金	14,534	12,873
その他の引当金	2,492	2,388
その他	52,493	46,288
流動負債合計	382,578	295,876
固定負債		
その他の引当金	110	160
退職給付に係る負債	60,635	61,181
その他	5,478	6,465
固定負債合計	66,224	67,807
負債合計	448,802	363,683
純資産の部		
株主資本		
資本金	54,961	54,961
資本剰余金	78,011	78,011
利益剰余金	702,990	750,872
自己株式	△29,310	△31,525
株主資本合計	806,652	852,318
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	20,126	45,884
繰延ヘッジ損益	△52	50
為替換算調整勘定	△4,111	△577
退職給付に係る調整累計額	△3,313	△2,886
その他の包括利益累計額合計	12,648	42,471
新株予約権	10,391	11,933
純資産合計	829,692	906,723
負債純資産合計	1,278,495	1,270,407

## (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

## 四半期連結損益計算書

## 第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
売上高	803,896	959,885
売上原価	481,819	573,149
売上総利益	322,076	386,736
販売費及び一般管理費		
研究開発費	86,784	99,475
その他	68,128	76,963
販売費及び一般管理費合計	154,912	176,439
営業利益	167,164	210,297
営業外収益		
受取配当金	802	778
為替差益	1,510	—
その他	2,683	2,804
営業外収益合計	4,996	3,583
営業外費用		
為替差損	—	2,481
自己株式取得費用	174	—
関税追加徴収額	173	—
その他	168	746
営業外費用合計	515	3,227
経常利益	171,645	210,652
特別利益		
固定資産売却益	31	20
特別利益合計	31	20
特別損失		
固定資産除売却損	380	627
その他	41	—
特別損失合計	421	627
税金等調整前四半期純利益	171,255	210,044
法人税等	43,203	51,864
四半期純利益	128,052	158,179
親会社株主に帰属する四半期純利益	128,052	158,179

四半期連結包括利益計算書  
第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
四半期純利益	128,052	158,179
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	11,515	25,745
繰延ヘッジ損益	△38	93
為替換算調整勘定	△3,821	3,582
退職給付に係る調整額	1,886	438
持分法適用会社に対する持分相当額	6	△37
その他の包括利益合計	9,548	29,822
四半期包括利益	137,600	188,002
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	137,600	188,002

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

税金費用の計算

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

① 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、BU(ビジネスユニット)を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「半導体製造装置」及び「FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置」を報告セグメントとしております。

「半導体製造装置」の製品は、ウェーハ処理工程で使われるコータ/デベロッパ、エッチング装置、成膜装置、洗浄装置、ウェーハ検査工程で使われるウェーハプローバ及びその他半導体製造装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「FPD製造装置」の製品は、フラットパネルディスプレイ製造用のコータ/デベロッパ、エッチング/アッシング装置及び有機ELディスプレイ製造用インクジェット描画装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)

(単位：百万円)

	報告セグメント		その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 3
	半導体 製造装置	FPD 製造装置				
売上高	899,762	60,025	15,961	975,748	△15,863	959,885
セグメント利益	237,186	7,616	643	245,445	△35,400	210,044

- (注) 1. 「その他」は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループの物流・施設管理・保険業務等であります。
2. セグメント利益の調整額△35,400百万円は、報告セグメントに帰属しない当社における基礎研究又は要素研究等の研究開発費△16,216百万円、及びその他の一般管理費等であります。
3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。

③ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。